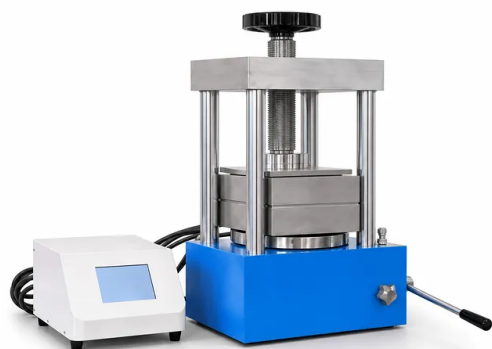


Prensa De Aquecimento Integrada De 24 Toneladas E 200X200Mm Para Preparação De Amostras De Laboratório

Número do item: XP55



introdução

Prensa de aquecimento integrada profissional com força de fixação de 24 toneladas e placas aquecidas de 200x200mm, ideal para pesquisa de baterias, testes de materiais e preparação de amostras. O controle de temperatura de precisão de até 300°C garante resultados confiáveis e consistentes.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Chave
Prensagem de Eletrodos & Eletrólito de Bateria	Consolidação de pós de cátodo/ânodo e formação de pastilhas de eletrólito de estado sólido para células de íon-lítio e baterias de próxima geração.	A distribuição uniforme de densidade previne pontos quentes e garante condutividade iônica consistente em toda a pastilha.
Gravação a Quente & Laminação de Filme Polimérico	Ligação térmica de filmes poliméricos multicamadas, vedação de chips microfluídicos e texturização de superfície para dispositivos lab-on-a-chip.	O controle preciso de temperatura e pressão preserva nanoestruturas delicadas sem degradação térmica.
Preparação de Pastilhas para FTIR & XRF	Produção de pastilhas transparentes de KBr para espectroscopia infravermelha e pérolas fundidas para análise de fluorescência de raios X.	Elimina inclusões de ar e variações de espessura, fornecendo linhas de base espectrais reproduzíveis.
Desenvolvimento de Material Compósito	Prensagem a quente de compósitos de matriz metálica, polímeros reforçados com cerâmica e consolidação de pré-impregnados de fibra de carbono.	Maximiza a impregnação da fibra e a eliminação de vazios sob perfis controlados de calor e pressão.
Produção Piloto de Comprimidos Farmacêuticos	Compressão de pequenos lotes de misturas de pó em comprimidos para testes de formulação e estudos de estabilidade.	O registro completo de dados dos parâmetros de prensagem auxilia na documentação FDA/EMA e em estudos de escalonamento.
Prensagem para Sinterização de Metalurgia do Pó	Pré-compactação de pós metálicos e cerâmicos em temperaturas elevadas antes da sinterização final.	Aumenta a densidade da peça crua e reduz o encolhimento na sinterização, melhorando a precisão da forma final.
Ligação de Wafers de Semicondutor	Ligação por compressão térmica de wafers de silício ou montagens chip-on-flex usando força e temperatura controladas.	Obtém linhas de ligação uniformes sem formação de vazios, crítico para a fabricação de sistemas microeletromecânicos (MEMS).

Parâmetro	XP55
Modelo	XP55
Capacidade da Prensa	0 - 24 toneladas
Temperatura de Trabalho da Placa	Ambiente - 300 °C
Potência de Aquecimento (Total)	1200 W (2 x 600 W)
Dimensões da Placa	200 x 200 mm
Resfriamento da Placa	Circulação de água integrada
Controle de Temperatura	PID de dupla zona com estabilidade de ± 2 °C
Exibição & Controle	Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas, programável
Fonte de Alimentação	220 V, 50 Hz, monofásica

Parâmetro	XP55
Dimensões Gerais (L x P x A)	950 x 260 x 525 mm
Peso Líquido	180 kg